

第八届先进电子材料、计算机与软件工程国际学术会议 (AEMCSE 2025)

2025 8th International Conference on Advanced Electronic Materials, Computers and Software Engineering

2025年5月9-11日 中国南京 会议官网: <http://www.aemcse.org>

会议通知

尊敬的各位专家学者:

第八届先进电子材料、计算机与软件工程国际学术会议 (AEMCSE 2025) 由南京信息工程大学主办, 将于2025年5月9日至11日在美丽的南京召开。这一高水平的国际会议旨在为全球学术界和工业界的专家、学者、研究人员和技术人员提供一个交流思想、分享最新成果以及讨论未来发展趋势的多元化平台。

此次会议将涵盖许多关键主题, 包括但不限于先进电子材料的新型发展、计算机技术的前沿应用、以及软件工程领域的创新与挑战。与会者将有机会聆听来自全球权威专家的主题演讲, 参与深度的专题研讨会, 并展示自己的研究工作和实践经验。通过这些丰富多彩的活动, 会议希望能在促成技术创新与突破的同时, 推动跨领域的融合与合作。

诚邀全球各地的专家学者共同参与此次学术盛会。会议期间, 参会者不仅可以获得宝贵的知识和专业见解, 还可以亲身体验南京作为中国历史文化名城的独特魅力。我们期待着在此次会议上与您相聚, 共同为电子材料、计算机与软件工程领域的未来贡献智慧。

一、组织单位和报告嘉宾

主办单位: 南京信息工程大学、江苏省第十七批科技镇长团南京市新材料产业团

协办单位: 东北大学医学影像智能计算教育部重点实验室

承办单位: 南京信息工程大学软件学院、南京信息工程大学化学与材料学院、AEIC学术交流中心、GSRA学术会议

大会主席:

Yonghui Li, The University of Sydney, Australia (IEEE Fellow, ARC Future Fellow)

张磊, 南京信息工程大学

程序委员会主席:

Benjamin W. Wah, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, China (AAAS/ACM/IEEE Fellow)

Witold Pedrycz, University of Alberta, Canada (IEEE Fellow)

巨传友, 南京信息工程大学(软件工程学院书记)

覃文军, 东北大学(计算机科学与工程学院副院长)

组织委员会主席:

耿东生, 南京信息工程大学(化学与材料学院院长)

张国臻, 南京信息工程大学

出版主席:

邵绍锋, 南京信息工程大学

韦松, 南京信息工程大学

组织委员会成员:

赖敏, 南京信息工程大学(物理与光电工程学院副院长)

李敬发, 南京信息工程大学(化学与材料学院副院长)

李庆芳, 南京信息工程大学

第八届先进电子材料、计算机与软件工程国际学术会议 (AEMCSE 2025)

2025 8th International Conference on Advanced Electronic Materials, Computers and Software Engineering

2025年5月9-11日 中国南京 会议官网: <http://www.aemcse.org>

程序委员会成员成员:

李敬发, 南京信息工程大学 (化学与材料学院副院长)

李庆芳, 南京信息工程大学

更多委员会信息请前往官网查看 ([点击查看](#))

报告嘉宾 (更多嘉宾信息待后续更新):

华云生教授, 香港中文大学 (AAAS/ACM/IEEE Fellow)

Prof. Yonghui Li, The University of Sydney, Australia (IEEE Fellow, ARC Future Fellow)

二、会议征稿主题 (包括但不限于以下内容)

计算机工程	软件工程	先进电子材料
人工智能与机器学习	软件架构与设计	纳米材料与纳米技术
边缘计算与物联网	软件测试与质量保证	半导体材料与器件
高性能计算与并行计算	云计算与服务导向	电子封装与互联技术
计算机系统与架构设计	架构移动应用开发与平台	柔性电子与智能穿戴设备
计算机网络与通信	用户界面设计与用户体验	高频电子材料与应用
嵌入式系统与实时系统	软件项目管理与敏捷开发	电子陶瓷与催化材料
分布式系统与云计算	DevOps与持续交付	光电材料与LED技术
数据中心技术	软件体系结构	热电材料与热管理技术
计算机视觉与图像处理	软件维护与演化	电池技术与能源存储
网络安全与隐私保护	云原生与微服务架构	新型显示技术与材料
先进计算与数据处理	区块链与智能合约	其他相关主题
体系结构与软件技术	人机交互与用户体验	
移动互联与通信技术	自动化软件设计和合成	
	编程语言和软件工程	

三、论文出版

所有的投稿都必须经过2-3位评审专家审稿, 经过严格的审稿之后, 最终录用的论文将发表在IEEE出版的会议论文集 (ISBN:979-8-3315-1091-6), 见刊后提交至IEEE Xplore、EI Compendex, Scopus检索。(前七届均已EI检索! 请前往官网查看检索记录)

投稿链接: <https://www.ais.cn/attendees/paperSubmit/AEUNV2>

论文模板: <https://www.ais.cn/attendees/material/AEUNV2>

参会链接: <https://www.ais.cn/attendees/toSignUp/AEUNV2>

1. 本次会议不接收综述文, 论文必须是英语稿件, 且未在国内外学术期刊和会议发表过。
2. 发表论文的作者需提交全文进行同行评审。
3. 论文必须按模板排版, 不得少于双栏4页, 最多为12页。
4. 论文全文重复率不超过30% (查重内容包含参考文献), 作者可通过iThenticate或其他查询系统自费查重, 否则由文章重复率引起的被拒稿将由作者自行承担。
5. 涉嫌抄袭的论文将不被出版, 且公布在会议主页。
6. 投稿作者可免费参会, 请在注册后前往报名系统报名参会。

四、会议注册费用

第八届先进电子材料、计算机与软件工程国际学术会议 (AEMCSE 2025)

2025 8th International Conference on Advanced Electronic Materials, Computers and Software Engineering

2025年5月9-11日 中国·南京 会议官网: <http://www.aemcse.org>

费用标准: 论文注册费用为 3800 元/篇 (双栏4页); 超页费为 400 元/页; 无投稿听众/海报展示/口头报告参会注册费用为 1500 元/人。

收费说明: 本次会议委托广州科奥信息技术股份有限公司承办, 并由其代收中国大陆作者的会议注册费并出具发票。

支付方式如下:

单位名称: 广州科奥信息技术股份有限公司

开户行: 中国工商银行广州育蕾街支行

银行账号: 3602879819100299208

五、联系方式

会议官网: <http://www.aemcse.org>

会议邮箱: AEMCSE@163.com

会务组郭老师 (填写邀请码G668跟进论文录用情况)

电话/微信: 18124944750

第八届先进电子材料、计算机与软件工程国际学术会议 (AEMCSE 2025)
2025年1月22日

